

플라스틱 반도체 칩 상용화 눈앞

WEF, 기술 선구자 선정 ... 실리콘보다 생산단가 저렴하고 유연

플라스틱 전자기술을 개발한 영국의 Plastic Logic이 세계경제포럼(WEF)에 의해 <기술 선구자>로 선정됐다.

반도체 전문 뉴스 사이트 Silicon Strategies에 따르면, 영국 케임브리지대학의 교수, 박사 등이 2000년 설립한 Plastic Logic은 컬러잡지를 인쇄하는 것처럼 쉽게, 그리고 매우싼 비용으로 생산할 수 있는 플라스틱 반도체 칩을 개발했으며 앞으로 수년 안에 상용할 계획으로 알려졌다.

플라스틱 반도체는 실리콘 반도체만큼 강력하지는 못하지만 유연하고 매우 얇으며 제조비용이 수천분의 1에 불과하다는 점에서 반도체 기술에 새로운 혁명을 일으킬 것으로 전망되고 있다.

Plastic Logic의 스튜어트 에번스 CEO는 2004년 1월 WEF 연례회의가 열리는 스위스 다보스로가 플라스틱 반도체 등 기술혁신을 논의하는 한 위원회에 참석할 예정이다.

<Chemical Journal 2003/12/30>